

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-007

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2020年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 37,800 万元至 39,000 万元，同比增长 249.01%至 260.09%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 32,500 万元至 33,500 万元，同比增长 395.09%至 410.33%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 37,800 万元至 39,000 万元，同比增长 249.01%至 260.09%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 32,500 万元至 33,500 万元，同比增长 395.09%至 410.33%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：10,830.50 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,564.42 万元。

(二) 每股收益：0.47 元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一) 公司专注于传感器领域的先进封装技术服务，受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等因素，公司生产订单饱满，各季度封装业务量呈现快速增长态势，随着产能与生产规模的持续提升，盈利能力边际提升效应逐步显现。

(二) 为把握市场机遇，公司一方面加强晶圆级TSV封装技术工艺的持续创新，工艺、设备、材料供应链的资源整合与生产能力显著提升，并在汽车电子等新应用领域实现逐步量产；另一方面推进新工艺能力的开发与拓展，如Fan-out技术的开发与生产逐步稳定，在大尺寸高像素领域开始有所应用。

(三) 为满足订单的持续增长，公司积极推进生产能力的规划与扩充，运营效率与管理水平的内部挖潜，不断增强核心战略客户的深度合作与共赢发展。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年1月26日